



# TSMC (TSM.US)

매출총이익률, 수년간의 하락세 진입

- 1Q26CY 실적, 시장 컨센서스 상회
- 2Q25CY 가이드언스, 2026년 실적 및 CapEx 전망치 모두 시장 기대치 상회
- 다만 해외 공장 가동에 따른 수년간의 수익성 하락 언급, 단기적 주가 약세 예상

## 1Q26CY 실적, 컨센서스 상회

TSMC의 1Q26CY 실적이 매출액 USD 35.9B(+6%QoQ, +41%YoY)와 영업이익 USD 20.8B(+14%QoQ, +68%YoY)를 기록하며, 분기 초 가이드언스 및 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 USD 35.5B, 영업이익 USD 19.7B)를 상회했다. 매출액의 경우 이미 1월 ~ 3월 숫자가 공개되었기 때문에 기대치를 넘어설 것으로 예상됐지만, 가동률 상승과 비용 개선 노력을 통해 지난 분기 대비 +4%p의 GPm 증가를 이룬 것은 인상적이었다.

## 2Q26CY 실적 가이드언스, 시장 컨센서스 상회

2Q26CY 실적 가이드언스는 매출액 USD 39.0~40.2B(+9~12%QoQ, +29~33%YoY), 영업이익 USD 22.0~23.5B(+6~13%QoQ, +46~56%YoY)로 제시되며, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 USD 38.1B, 영업이익 USD 21.0B)를 대폭 상회했다. 또한 연간 매출액 가이드언스를 전년 대비 +30% 이상 성장으로 상향 조정했으며, 올해 CapEx도 기존 가이드언스인 USD 52~56B의 상단을 기록할 것이라고 톤을 높였다. 경기 불확실성과 메모리 가격 급등으로 인해 PC와 스마트폰 수요에 대한 우려감을 표현하기는 했지만, AI 수요가 매우 견조하고 파운드리 capacity의 제약도 여전하다는 것이 매출액과 CapEx 가이드언스의 상향 조정 이유였다.

## 수익성 우려 가중, 매출총이익률 하락 전환 시작

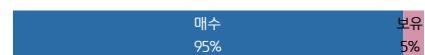
놀라운 실적 및 가이드언스에도, 컨퍼런스 콜 중 투자자들의 관심은 파운드리 경쟁 심화 우려와 해외 공장 가동에 따른 수익성 하락에 더욱 집중하는 모습을 보였다. TSMC의 가이드언스를 반영하면, AI 시장 성장과 함께 꾸준히 개선세를 보였던 매출총이익률이 2028~2029년까지 감소세 흐름을 보일 것이고, 이는 아직 컨센서스에 반영되어 있지 않다. 단기적으로는 보수적 접근이 바람직하다고 판단한다.

## ▶ 현재주가 / 목표주가 컨센서스

현재주가('26.04.16): \$363.35

목표주가 컨센서스: \$421.36

## ▶ 투자 의견 컨센서스



### Stock Data

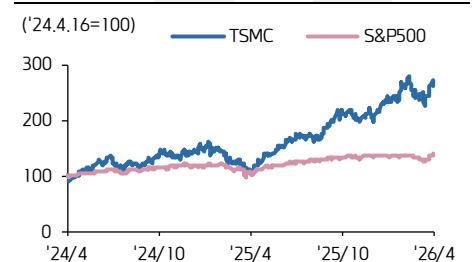
산업분류	반도체 & 반도체 장비
S&P 500 (4/16)	7,041.28
현재주가/목표주가	363.35 / 421.36
52주 최고/최저 (\$)	390.21 / 145.84
시가총액 (백만\$)	1,711,758
유통주식 수 (백만)	5,183
일평균거래량 (3M)	13,565,760

### Earnings & Valuation

(백만 \$)	FY24	FY25	FY26E	FY27E
매출액	90,083	122,424	157,849	196,777
영업이익	41,148	62,226	85,496	109,459
OPM(%)	45.7	50.8	54.2	55.6
순이익	36,517	55,213	73,900	90,282
EPS	7.0	10.7	14.6	18.3
증가율(%)	35.6	51.3	37.0	25.4
PER(배)	27.8	28.4	24.9	19.9
PBR(배)	7.8	9.1	15.8	12.3
ROE(%)	30.0	35.4	35.8	33.7
배당수익률(%)	1.0	-	1.1	1.2

### Performance & Price Trend

주가수익률 (%)	YTD	1M	6M	12M
절대	19.6	6.8	21.2	139.6
S&P Index	2.6	5.9	5.3	30.1



자료: 데이터 스트림 컨센서스, 키움증권 리서치센터

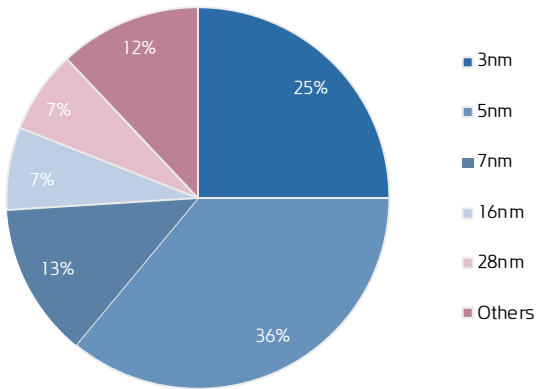
TSMC 실적 추이 및 전망 (단위: 백만달러)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
<b>매출액</b>	<b>25,512</b>	<b>30,318</b>	<b>33,073</b>	<b>33,698</b>	<b>35,858</b>	<b>38,701</b>	<b>42,592</b>	<b>44,784</b>	<b>122,600</b>	<b>161,935</b>	<b>202,101</b>
%QoQ/%YoY	-5%	19%	9%	2%	6%	8%	10%	5%	36%	32%	25%
<b>HPC</b>	<b>14,993</b>	<b>18,219</b>	<b>18,663</b>	<b>18,682</b>	<b>21,873</b>	<b>24,159</b>	<b>25,666</b>	<b>26,429</b>	<b>70,557</b>	<b>98,127</b>	<b>124,811</b>
%QoQ/%YoY	5%	22%	2%	0%	17%	10%	6%	3%	54%	39%	27%
<b>Smartphone</b>	<b>7,101</b>	<b>8,116</b>	<b>9,914</b>	<b>10,646</b>	<b>9,323</b>	<b>8,797</b>	<b>10,388</b>	<b>11,172</b>	<b>35,777</b>	<b>39,680</b>	<b>40,477</b>
%QoQ/%YoY	-23%	14%	22%	7%	-12%	-6%	18%	8%	14%	11%	2%
<b>Internet of Things</b>	<b>1,177</b>	<b>1,438</b>	<b>1,779</b>	<b>1,764</b>	<b>2,151</b>	<b>1,685</b>	<b>1,883</b>	<b>1,728</b>	<b>6,159</b>	<b>7,447</b>	<b>7,531</b>
%QoQ/%YoY	-11%	22%	24%	-1%	22%	-22%	12%	-8%	20%	21%	1%
<b>Automotive</b>	<b>1,308</b>	<b>1,397</b>	<b>1,690</b>	<b>1,611</b>	<b>1,434</b>	<b>1,741</b>	<b>1,817</b>	<b>1,937</b>	<b>6,007</b>	<b>6,929</b>	<b>9,265</b>
%QoQ/%YoY	12%	7%	21%	-5%	-11%	21%	4%	7%	39%	15%	34%
<b>DCE</b>	<b>351</b>	<b>487</b>	<b>402</b>	<b>304</b>	<b>359</b>	<b>458</b>	<b>412</b>	<b>377</b>	<b>1,543</b>	<b>1,605</b>	<b>1,896</b>
%QoQ/%YoY	6%	39%	-18%	-24%	18%	28%	-10%	-8%	3%	4%	18%
<b>매출액 비중(Technology)</b>											
3nm	22%	24%	23%	28%	25%	31%	31%	31%	24%	29%	29%
5nm	36%	36%	37%	35%	36%	30%	28%	26%	36%	30%	22%
7nm	15%	14%	14%	14%	13%	12%	11%	11%	14%	12%	10%
16/20nm	7%	7%	7%	6%	7%	6%	6%	5%	7%	6%	5%
28nm	7%	7%	7%	6%	7%	6%	6%	5%	7%	6%	5%
Others	13%	12%	12%	11%	12%	15%	19%	22%	12%	17%	27%
<b>매출원가</b>	<b>10,513</b>	<b>12,546</b>	<b>13,410</b>	<b>12,695</b>	<b>12,104</b>	<b>13,553</b>	<b>15,482</b>	<b>16,663</b>	<b>49,165</b>	<b>57,802</b>	<b>72,015</b>
매출원가율	41%	41%	41%	38%	34%	35%	36%	37%	40%	36%	36%
<b>매출총이익</b>	<b>14,998</b>	<b>17,772</b>	<b>19,663</b>	<b>21,002</b>	<b>23,754</b>	<b>25,148</b>	<b>27,111</b>	<b>28,120</b>	<b>73,435</b>	<b>104,133</b>	<b>130,086</b>
판매비와 관리비	871	754	803	752	830	968	1,019	1,071	3,179	3,888	4,731
<b>영업이익</b>	<b>12,375</b>	<b>15,046</b>	<b>16,728</b>	<b>18,197</b>	<b>20,835</b>	<b>21,788</b>	<b>23,548</b>	<b>24,519</b>	<b>62,346</b>	<b>90,691</b>	<b>113,128</b>
%QoQ/%YoY	-6%	22%	11%	9%	14%	5%	8%	4%	52%	45%	25%
영업이익률	49%	50%	51%	54%	58%	56%	55%	55%	51%	56%	56%
법인세차감전순이익	13,098	16,008	17,553	19,082	21,747	22,581	24,439	25,418	65,740	94,185	117,162
법인세비용	2,108	3,077	2,441	2,790	3,646	3,994	4,052	4,164	10,416	15,857	20,557
<b>당기순이익</b>	<b>10,991</b>	<b>12,931</b>	<b>15,111</b>	<b>16,291</b>	<b>18,101</b>	<b>18,587</b>	<b>20,387</b>	<b>21,254</b>	<b>55,324</b>	<b>78,328</b>	<b>96,605</b>
당기순이익률	43%	43%	46%	48%	50%	48%	48%	47%	45%	48%	48%
<b>CapEx</b>	<b>10,057</b>	<b>9,650</b>	<b>9,604</b>	<b>11,497</b>	<b>11,090</b>	<b>13,491</b>	<b>13,575</b>	<b>15,733</b>	<b>40,807</b>	<b>53,889</b>	<b>63,147</b>
%QoQ/%YoY	-10%	-4%	0%	20%	-4%	22%	1%	16%	37%	32%	17%
<b>감가상각비</b>	<b>5,324</b>	<b>6,106</b>	<b>5,439</b>	<b>5,222</b>	<b>5,231</b>	<b>6,239</b>	<b>6,689</b>	<b>7,217</b>	<b>22,090</b>	<b>25,377</b>	<b>31,761</b>
%QoQ/%YoY	1%	15%	-11%	-4%	0%	19%	7%	8%	7%	15%	25%
USD/TWD	32.88	31.05	29.91	31.01	31.59				31.21		

주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2026/04/16), 실적은 Non-GAAP, CY 기준 (회계 기준 결산일은 12/31일)

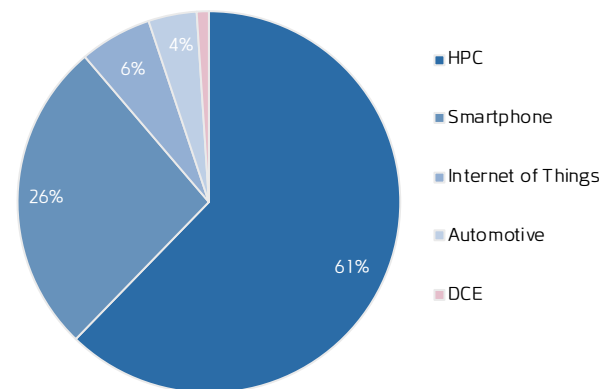
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

TSMC 1Q26 Revenue by Technology



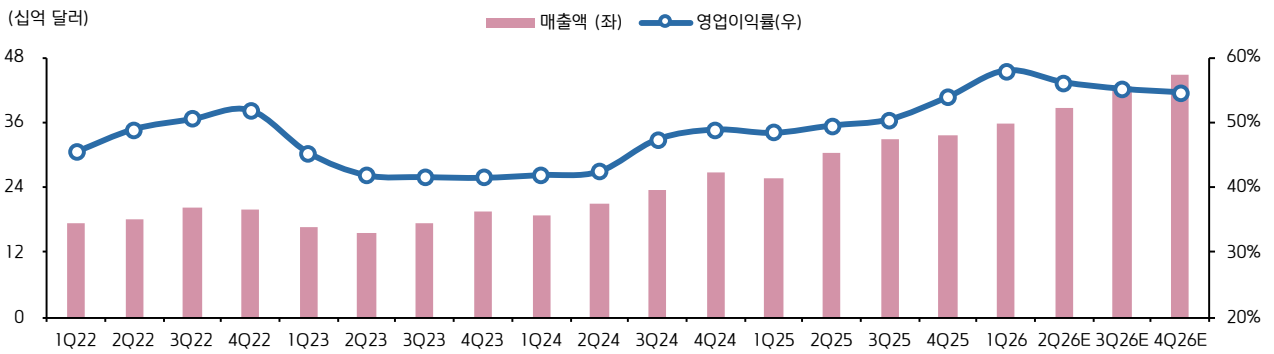
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

TSMC 1Q26 Revenue by Platform



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

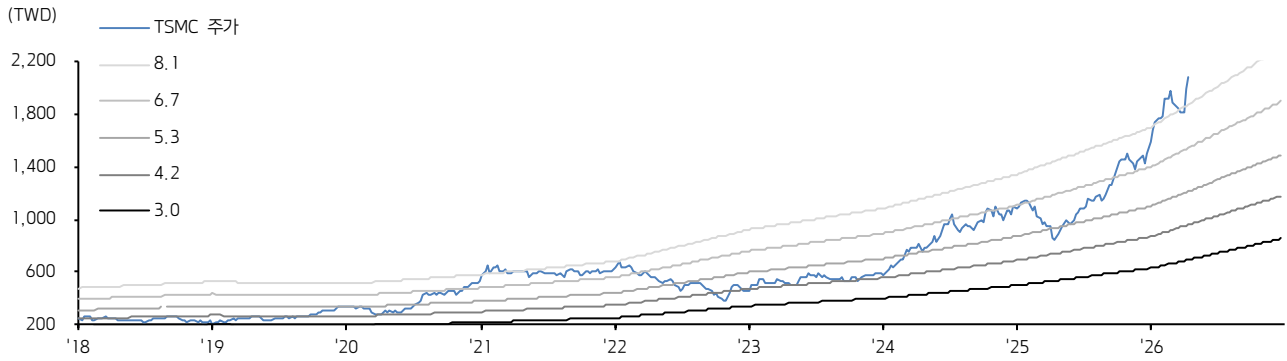
TSMC 매출액 및 영업이익률 추이



주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2026/04/16)

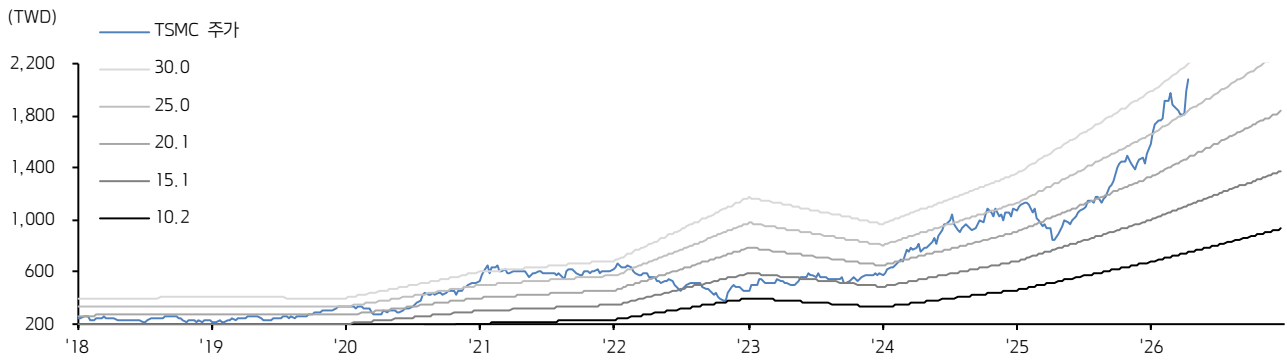
자료: TSMC, 키움증권 리서치센터

TSMC 12개월 Trailing P/B Chart



주: 4/16 종가 기준  
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

TSMC 12개월 Trailing P/E Chart



주: 4/16 종가 기준  
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

글로벌 Tech 기업 주가 및 Valuation

(십억달러, 배, %)		Mkt Cap	ID	%CHG			P/E		P/B		EV/EBITDA		Rev		OP		EBITDA		ROE		
			5D	1M	3M	6M	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	
Memory	Micron	515.6	0.2	8.5	3.5	26.0	125.8	5.4	4.3	3.4	2.1	3.8	2.6	148.2	187.5	114.8	142.9	125.0	155.1	67.7	54.0
	Sandisk	141.0	3.1	8.0	30.7	122.3	537.3	10.0	8.8	6.1	3.8	8.1	6.9	26.0	30.2	16.7	19.9	16.6	18.8	50.9	43.7
	Kioxia	116.1	4.5	22.3	56.7	129.6	416.3	7.0	5.0	6.0	3.1	4.5	3.0	34.0	46.5	22.3	29.6	24.3	30.4	90.1	77.2
	Seagate	116.0	2.3	6.2	33.4	63.0	135.3	31.8	22.5	40.4	17.8	23.1	16.4	13.0	15.9	4.9	6.6	5.1	6.9	248.3	109.1
	Western Digital	122.6	-0.9	7.0	26.4	63.3	187.2	32.1	22.0	10.5	7.9	20.4	14.5	14.2	17.5	5.4	7.4	5.9	8.0	48.3	50.4
	Nanya	21.0	0.9	4.1	-21.4	-14.6	105.3	5.2	4.8	2.2	1.5	3.0	2.3	7.8	9.1	5.2	5.8	5.4	6.2	46.9	35.8
Logic	Intel	343.9	5.5	11.0	49.7	45.9	85.9	120.2	62.3	2.8	2.6	23.3	18.0	54.4	58.5	4.1	7.5	15.9	19.1	1.4	3.4
	Nvidia	4,819.9	-0.3	7.9	8.3	6.5	9.1	24.8	18.1	17.1	10.6	19.2	13.6	359.0	484.9	238.3	322.1	243.9	331.1	84.8	67.1
	AMD	453.7	7.8	17.6	41.6	20.0	18.6	41.2	25.0	6.5	5.8	33.8	20.1	47.0	67.5	12.8	21.6	12.9	21.6	13.1	19.3
	Broadcom	1,886.6	0.4	12.3	22.6	13.3	12.5	31.4	21.0	15.8	10.1	23.8	15.6	114.3	167.6	76.9	113.7	79.5	117.2	57.4	59.5
	Marvell	116.6	-0.9	11.2	45.6	65.8	51.2	36.1	25.3	7.4	6.4	28.4	20.2	10.6	14.3	3.8	5.4	4.1	5.7	10.2	11.3
	Qualcomm	143.5	1.1	5.3	3.9	-15.7	-18.0	12.9	11.8	6.4	6.2	10.2	9.8	42.4	44.3	13.0	13.8	14.3	14.6	48.9	48.6
	Arm	172.4	1.9	8.4	33.4	53.5	-5.2	83.1	59.1	17.4	13.5	65.9	46.1	5.6	7.2	2.3	3.3	2.5	3.6	18.2	20.0
	Skyworks	8.8	1.3	3.8	7.6	1.6	-21.2	13.0	11.3	1.7	1.8	7.8	6.8	3.7	4.0	0.7	0.9	1.1	1.3	8.8	9.6
	TI	203.1	3.1	3.8	14.9	16.5	27.1	34.4	28.6	12.3	11.6	22.5	18.7	19.6	21.6	7.1	8.4	9.4	11.3	35.6	41.7
	ADI	172.7	1.7	0.7	13.8	17.8	46.4	29.8	26.4	5.0	4.6	22.3	21.0	14.3	15.6	6.8	7.6	7.9	8.4	15.3	17.0
	NXP	54.0	2.1	3.9	11.4	-9.9	-1.7	15.3	12.8	4.7	4.2	11.3	9.7	13.5	14.9	4.7	5.5	5.5	6.2	31.9	34.8
	STMicro	37.9	2.2	6.2	24.2	48.3	41.7	36.2	20.4	2.0	1.9	11.3	8.3	13.4	15.1	1.1	2.1	3.1	4.1	5.7	9.5
	Microchip	41.6	3.2	7.9	20.4	2.9	17.6	31.6	22.2	6.4	6.1	22.0	17.2	5.5	6.5	1.8	2.4	2.2	2.7	20.3	26.9
	On Semi	31.4	10.4	16.7	33.5	32.5	50.9	27.1	19.6	4.2	3.7	16.8	13.6	6.3	6.9	1.3	1.8	1.9	2.3	14.7	20.7
	Silicon Motion	4.7	-1.5	7.9	8.8	21.4	48.3	23.9	18.0	4.7	3.8	16.3	N/A	1.2	1.4	0.2	0.3	0.3	0.4	21.4	26.8
Mediatek	96.3	5.9	20.3	9.5	25.9	42.5	29.9	19.2	6.9	6.0	22.8	14.0	19.9	27.3	3.2	5.2	3.9	6.3	25.3	35.7	
Renesas	32.5	3.5	6.6	11.4	18.8	43.9	12.2	11.3	1.9	1.7	11.2	9.8	9.4	10.1	2.0	2.4	3.2	3.5	12.9	11.8	
Novatek	7.9	1.7	3.1	8.1	9.0	1.6	15.4	14.2	3.5	3.5	10.8	9.6	3.2	3.4	0.6	0.6	0.6	0.7	23.9	25.6	
Foundry	TSMC	1,884.5	-3.1	-0.6	6.8	6.1	21.2	24.9	20.0	8.0	6.5	15.6	12.2	161.1	202.2	89.2	111.7	115.5	144.4	37.1	35.5
	SMIC	76.6	1.1	7.6	-3.1	-24.3	-13.2	61.8	46.4	2.7	2.5	16.9	14.0	11.1	12.9	1.2	1.6	5.8	7.1	4.4	5.3
	UMC	26.7	6.7	11.4	12.1	14.2	42.9	19.2	16.7	2.1	1.9	N/A	N/A	8.2	9.0	1.6	1.9	3.6	4.0	10.9	12.5
	GFS	28.0	4.3	3.5	15.1	22.2	45.7	27.8	21.5	2.2	2.1	10.2	8.5	7.2	7.9	1.2	1.5	2.5	2.9	8.0	9.8
	VIS	7.8	3.9	0.8	11.8	-5.0	33.6	27.1	24.4	3.5	3.2	15.7	13.6	1.8	2.1	0.3	0.4	0.6	0.8	13.5	14.6
Packaging	ASE	61.5	1.4	12.6	28.3	42.2	119.4	30.7	22.0	N/A	N/A	N/A	N/A	23.9	27.9	2.6	3.7	5.1	6.6	N/A	N/A
	Amkor	15.6	5.3	14.1	40.9	31.0	99.7	37.3	27.1	3.1	2.8	12.8	10.1	7.4	8.2	0.6	0.7	1.3	1.6	8.7	11.0
	Agilent	33.4	-1.3	2.5	5.7	-15.3	-16.2	19.5	17.6	4.3	3.8	15.7	14.2	7.5	7.9	2.0	2.2	2.2	2.4	22.8	22.5
	Chipbond	2.7	7.5	18.1	74.3	99.0	99.0	26.9	26.1	1.8	1.7	13.0	12.8	0.7	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2	6.7	6.7
Equipment	ASML	547.6	-4.8	-2.6	2.6	3.8	38.4	38.6	29.6	19.4	14.7	29.9	22.9	46.0	55.1	16.7	21.7	17.9	23.1	53.7	55.8
	AMAT	309.4	-1.1	-2.0	12.6	19.2	71.2	33.3	26.7	12.2	10.6	27.5	21.9	32.9	38.8	10.4	12.9	11.1	13.9	38.2	40.2
	LAM Research	325.9	-1.6	0.9	18.9	17.0	83.3	41.9	31.8	22.5	16.1	34.5	27.4	25.5	31.3	9.0	11.8	9.4	11.7	64.6	64.4
	TEL	135.8	5.3	8.6	18.2	8.7	52.3	31.6	27.2	9.2	7.9	23.8	18.6	17.6	19.3	4.8	5.7	5.5	7.0	29.3	31.2
	KLA	227.4	-0.8	0.4	20.6	10.7	57.9	41.2	33.0	30.8	23.9	33.0	26.8	14.9	17.6	6.5	8.0	6.9	8.5	89.7	84.2
	AMEC	29.3	-0.6	-0.9	1.8	-15.5	21.6	62.8	45.0	7.8	6.7	54.7	38.0	2.4	3.1	0.5	0.7	0.5	0.7	12.9	15.6
Naura	50.3	-0.3	0.2	5.2	-9.6	18.6	35.8	28.3	7.2	5.8	28.5	22.3	7.3	9.1	1.6	2.0	1.7	2.2	21.2	22.0	
Materials	Linde	231.2	0.3	-1.5	-1.9	12.0	28.0	25.6	5.8	5.5	18.0	16.9	35.6	37.3	10.7	11.5	14.1	15.1	20.6	21.5	
	Air Liquid	127.2	-0.4	-0.4	8.2	17.1	7.1	26.5	23.9	3.8	3.5	13.6	12.5	33.1	34.7	7.2	7.8	10.3	11.2	14.9	15.5
	Air Products	66.2	0.7	-0.2	2.8	11.1	17.4	22.3	20.6	3.8	3.5	15.4	14.5	12.9	13.6	3.3	4.2	5.6	5.9	17.9	17.9
	Merck KGaA	59.0	-1.7	3.4	6.4	-11.4	3.0	14.8	13.5	1.6	1.5	9.7	8.8	24.7	25.9	4.5	5.0	6.9	7.4	10.7	11.4
	ADEKA	2.6	0.7	2.9	-0.2	-10.3	19.2	16.8	14.5	1.2	1.2	9.2	9.7	2.7	2.2	0.3	0.3	0.3	0.3	9.0	9.4
	Resonac	15.3	2.5	1.3	24.3	69.8	127.8	30.1	22.1	3.3	2.9	13.8	11.4	8.6	8.5	0.7	1.0	1.4	1.7	11.4	14.4
	Siltronic	2.4	4.9	15.1	18.9	22.2	23.6	N/A	N/A	1.3	1.4	11.3	8.5	1.5	1.7	-0.2	-0.1	0.3	0.4	-12.4	-9.6
Sumco	5.1	4.0	19.4	43.8	44.7	40.3	N/A	35.6	1.5	1.4	8.8	7.0	2.7	2.9	-0.1	0.2	0.8	0.9	-2.9	3.6	
Server	Dell	124.7	8.9	6.4	23.3	60.2	27.6	14.9	13.3	N/A	64.3	9.9	9.1	140.6	152.0	11.8	12.8	14.4	15.4	-413.3	-232.3
	HPE	34.4	5.2	4.3	18.5	20.8	15.1	10.8	9.4	1.4	1.3	6.9	6.2	41.4	43.6	4.6	5.2	7.3	7.9	13.6	14.4
	Lenovo	17.6	4.9	12.3	17.0	25.0	-0.5	13.0	11.4	2.3	1.9	4.4	3.7	86.1	93.6	2.7	3.0	4.0	4.4	25.3	25.0
	Quanta	39.0	3.2	1.8	10.2	10.0	10.4	14.1	12.1	4.7	4.1	11.1	9.3	97.7	122.0	3.4	4.0	3.8	4.5	33.7	35.6
	Inspur	14.7	-0.9	4.9	15.7	0.3	6.0	27.6	21.1	3.9	3.4	25.7	20.6	30.1	35.9	0.6	0.7	0.6	0.8	14.3	15.9
	Wiwynn	21.8	-0.5	3.4	-6.7	-3.3	-2.2	11.3	9.1	4.7	3.4	8.2	6.5	41.5	56.4	2.5	3.2	2.7	3.3	44.0	41.9
	Inventec	5.1	1.2	2.7	2.3	1.5	2.6	15.8	13.2	2.2	2.3	11.4	9.8	23.9	26.4	0.5	0.5	0.6	0.7	13.9	16.2
	Mitac	3.5	1.0	5.9	-1.1	-0.6	-9.4	10.9	7.7	1.3	N/A	N/A	N/A	5.6	8.3	0.3	0.5	0.4	0.5	13.6	18.3
CSPs	Amazon	2,684.6	0.5	6.9	17.9	4.4	16.4	27.3	23.0	5.2	4.1	13.1	10.6	806.4	901.9	98.4	121.6	208.2	258.2	18.6	18.3
	Microsoft	3,120.7	2.2	12.																	

TSMC 관련 용어

용어	이미지	설명
N7 Node		7nm급 공정으로, 18년 양산을 시작해 3Q25 기준 14%의 매출 비중을 차지
N5 Node		5nm급 공정으로, 20년 양산을 시작해 3Q25 기준 37%의 매출 비중을 차지
N3 Node		3nm급 공정으로, 22년 양산을 시작해 3Q25 기준 23%의 매출 비중을 차지
N2 Node		2nm급 최첨단 공정으로, 25년 하반기 양산 예정
N2P Node		2nm급 최첨단 공정의 업그레이드 버전으로, 26년 하반기 양산 계획
A16 Node		1.6nm급 차세대 공정으로, 26년 하반기 양산 계획
A14 Node		1.4nm급 차세대 공정으로, 28년 양산 계획
HPC (High-Performance Computing)		AI 반도체가 탑재된 슈퍼컴퓨터 및 AI 데이터센터 관련 고성능컴퓨터 사업부문
IoT (Internet of Things)		웨어러블, 스마트 홈 등 사물 인터넷 애플리케이션 관련 사업부문
DCE (Digital Consumer Electronics)		스마트TV, 셋톱박스 등 디지털 소비자 전자제품 관련 사업부문
CoWoS (Chip on Wafer on Substrate)		2개 이상의 칩을 웨이퍼 상에서 연결해 기판에 올리는 TSMC의 고급 2.5D 반도체 패키징 기술
CoPoS (Chip on Panel on Substrate)		유리 기판과 패널을 활용해 기존 웨이퍼 기반 CoWoS 기술을 대체할 차세대 패널 레벨 패키징 기술
FOWLP (Fan-Out Wafer Level Packaging)		Fan-Out 구조를 활용해, I/O 단자 배선을 칩 밖으로 빼내어 성능과 열효율을 향상한 패키징 기술
SoIC (System on Integrated Chip)		초고밀도 수직 적층 구조를 통해 다양한 칩렛을 단일 칩으로 통합하는 패키징 기술
CPO (Co-packaged Optics)		단일 패키지 기판에 광학 소자와 실리콘을 이중 집적하여 전력 및 비용을 절감한 패키징 기술
MOSFET		반도체 기판에 Source와 Drain을 추가한 트랜지스터. 게이트의 전압을 조절해 전류를 제어
CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor)		PMOS와 NMOS가 상호보완적으로 활용되는 집적회로의 한 종류. 집적도가 높고 소모 전력이 적음
FinFET (Fin Field Effect Transistor)		게이트가 기판과 맞닿는 면이 1개인 MOSFET 대비 3면에서 채널을 형성해 소자 성능을 개선
GAA (Gate-All-Around)		채널을 게이트가 완전히 감싸는 구조로 보다 우수한 전류 제어 능력을 제공하는 구조

자료: TSMC, 삼성전자, SK하이닉스, 키움증권 리서치센터

#### Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

#### 고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.